



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	MEMS催化燃烧式氢气传感器
产品型号 MODEL	MS-H2-35BPC
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：http:// www.minsisensor.com

邮箱：minsi@ minsisensor.com



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属**敏思传感技术有限公司**(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用**敏思传感**的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

敏思传感技术有限公司



催化燃烧式氢气气体传感器

MS-H2-35BPC是一款基于MEMS硅基加热器的氢气催化燃烧传感器，在连续工作模式下具有低功耗特点，在脉冲工作模式下可提供超低功耗。传感器基于催化燃烧原理，由催化元件和参比元件组成，将两个元件封装到管壳结构中，并应用于测试电路中工作。当传感器遇氢气气体时催化元件电阻增加，测试电路的输出电压变化，该电压的变化量与气体浓度成正比例关系。



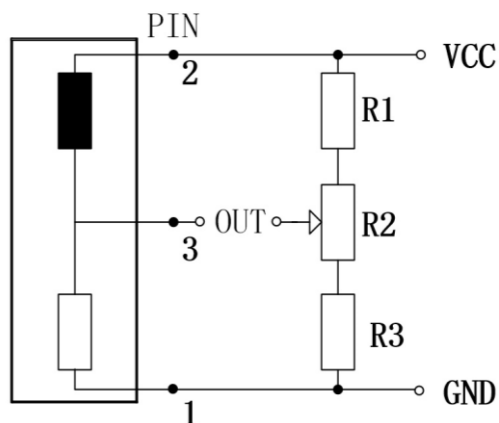
特点:

低功耗
线性输出
使用寿命长

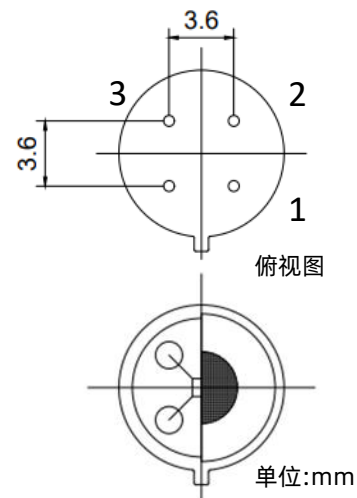
应用:

工业氢气气体的浓度检测
氢气气体泄漏报警器
便携式氢气气体探测器

电路图



结构图



传感器主要由催化元件（黑元件）和补偿元件（白元件）组成，黑、白两个元件被安装到电桥中，通过可变电阻可调整电桥输出稳定的基准信号。当环境中存在氢气气体时，在催化元件表面会发生燃烧，元件表面温度上升，导致元件电阻增加，电桥失衡，通过电路采集电桥的输出电压。

典型值:

$VCC=3.3\text{ V}$ $R1=R3=4.7\text{ K}\Omega$ $R2=500\text{ }\Omega$



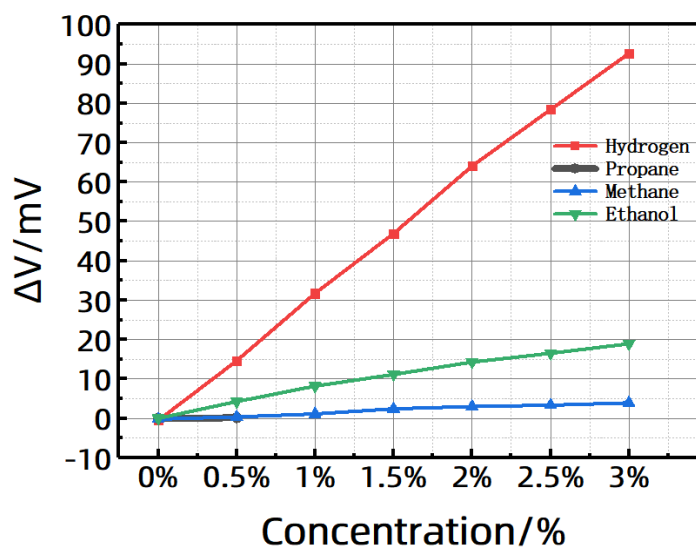
规格表

项目		典型值
封装形式	金属封装	
检测原理	催化燃烧	
检测对象	氢气气体	
检测范围	0%-3% (空气中)	
工作电压	3.3 ± 0.1 VDC	
标准测试条件	传感器电流	17.5 mA (典型)
	传感器功耗	56-61 mW (典型)
下的电器特性	传感器电阻	184~190 Ω
	灵敏度(ΔV)	20-50mV (1% H ₂)
标准测试条件	测试环境	20±2 °C, 65%±5% RH
	加热电压	3.3 VDC
	回路电压	3.3 VDC
工作环境	-10°C~+70°C, ≤95%RH (非冷凝)	
储存环境	-10°C~+80°C, ≤95%RH (非冷凝)	

灵敏度特性

下图是在标准试验条件下的灵敏度特性曲线。纵坐标为传感器在测试电桥中的输出电压变化量 ΔV (mV), 横坐标为气体浓度 (%)。

$\Delta V = V_{out}(\text{某浓度气体}) - V_{out}(\text{空气})$





注意事项

- 1、传感器的使用和储存必须避免长期暴露于强酸、强碱、强腐蚀性气体环境，否则会影响传感器性能，可能造成传感器不可恢复性劣变或损坏。
- 2、传感器的使用和储存必须避免一些影响催化元件的化合物，如含硅化合物、高浓度硫化物、含铅化合物、含磷化合物，否则会使催化材料中毒，影响传感器性能。
- 3、传感器在使用和储存过程中应避免环境温度和湿度超出传感器适用的温湿度，否则会影响传感器中的敏感材料层，使其性质变化，导致传感器损坏。
- 4、传感器使用过程中需按照规定施于加热电压以达到最优的测试性能。避免给于高电压，否则会导致传感器内部结构件不可逆损坏。
- 5、传感器需要在规定的目标气体浓度范围内进行检测，应避免长期处于高浓度目标气体，否则无法正常展现其传感性能，甚至可能导致传感器损坏。
- 6、传感器使用或运输过程中需要避免超高强度振动及冲击，如超声波振动等会造成传感核心元件损坏。